

华西证券股份有限公司

关于成都旭光电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐人”）作为成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光电子”、“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对旭光电子 2022 年非公开发行股票募集资金于 2025 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,495,898.79 元，实际募集资金净额为 534,504,090.90 元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第 0084 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年非公开发行股票
募集资金到账时间	2022年9月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	55,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,549.59

二、募集资金净额	53,450.41
减：	
以前年度已使用金额	28,724.80
本年度使用金额	7,638.05
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
置换预先投入募集资金金额	12,806.19
节余募集资金补流	5,144.66
加：	
利息收入及理财收益减除手续费净额	863.29
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐人华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2022年9月5日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都旭光电	中国工商银	4402943029100134835	0	已注销

发行名称			2022 年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2022 年 9 月 5 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
子股份有限公司	行股份有限公司成都马超西路支行			
成都旭光电子股份有限公司	成都银行犀浦支行	1001300001054898	0	已注销
成都旭光电子股份有限公司	中信银行股份有限公司成都锦江支行	8111001012800854425	0	已注销
宁夏北瓷新材料科技有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101001316867745	0	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，本次募集资金到位前，公司及实施募投项目的子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司（以下简称“宁夏北瓷”）根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。自 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 9 月 23 日止，公司及宁夏北瓷以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币 12,806.19 万元。截至 2022 年 9 月 23 日公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 148.34 万元。预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计 12,954.52 万元。

公司于 2022 年 9 月 28 日召开的公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 12,954.52 万元，上述事项已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于成都旭光电子股

份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（川华信专（2022）第 0631 号）。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 9 月 28 日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议及 2022 年 10 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的部分闲置募集资金及不超过 1.15 亿元（含）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2023 年 9 月 22 日召开的公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议及 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年11月24日，本公司第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第九次会议审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“电子封装陶瓷材料扩产项目”及“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”予以结项，并将节余募集资金5,141.16万元永久补充流动资金。此后，公司从四个募集资金专户转出节余募集资金共计5,144.66万元（与结项时金额的差异主要系结项日至实际转出日期间产生的利息收入），并同步完成了相关募集资金专户的销户手续。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年非公开发行股票				
募集资金到账日期			2022年9月5日				
节余募集资金合计金额			5,144.66				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
电子封装陶瓷材料扩产项目	1,913.87	用于补流				2025年11月24日	
电子陶瓷材料产业化项目（一期）	3,230.79	用于补流				2025年11月24日	

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司2024年第一次临时股东大会审批通过，决定将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”募集资金投入金额减少6,736.97万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目”，并相应增加“电子封装陶瓷材料扩产项目”的投资总额。“电子封装陶瓷材料扩产项目”及“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》（川华信专（2026）第0101000号），其鉴证结论为：我们认为，贵公司董事会编制的《成都旭光电子股份有限公司关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：旭光电子2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用2022年非公开发行股票募集资金的情形。

（以下无正文）

（华西证券股份有限公司关于成都旭光电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见）

保荐代表人：

王倩春

邓壹丹

华西证券股份有限公司

2026 年 3 月 20 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年非公开发行股票										
募集资金到账日期			2022 年 9 月 5 日										
本年度投入募集资金总额			7,638.05										
已累计投入募集资金总额			49,169.04										
变更用途的募集资金总额			6,736.97										
变更用途的募集资金总额比例			12.60%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子封装陶瓷材料扩产项目	生产建设	变更	13,670.86	20,407.83	20,407.83	1,309.23	18,506.02	-1,901.81	90.68	2025 年 10 月	-2,296.43	否	否
电子陶瓷材料产业化项目（一期）	生产建设	变更	31,979.55	25,242.58	25,242.58	6,328.82	22,863.02	-2,379.56	90.57	2025 年 10 月	-881.19	否	否
补充流动资金	补流		7,800.00	7,800.00	7,800.00		7,800.00	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			53,450.41	53,450.41	53,450.41	7,638.05	49,169.04	-4,281.37	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审批通过以下事项： 1、受前期市场环境及技术迭代影响，为进一步提升产品性能，“电子封装陶瓷材料扩产项目”生产设备的安装、优化调试仍需持										

	<p>续推进。同时结合公司目前发展战略要求，拟继续增加“电子封装陶瓷材料扩产项目”建设，因此结合募投项目实施进度，为维护公司及全体股东利益，公司经过综合分析和审慎评估，决定对“电子封装陶瓷材料扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。</p> <p>2、随着国内半导体市场的逐步升级，对相关产品的质量和性能也提出更高的要求，同时，氮化硅基板及 HTCC 涉及的制造工艺复杂，生产验证周期较长。因此，为确保产品质量与性能稳定，经公司充分考虑和审慎研究，为确保公司募投项目稳步实施，降低募投资金使用风险，保障资金的安全、合理使用，保护公司及投资者利益，结合目前项目实际开展情况，公司决定对“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。</p> <p>“电子封装陶瓷材料扩产项目”及“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”已于 2025 年 10 月达到预定可使用状态并予以结项。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：电子封装陶瓷材料扩产项目实际累计投入含项目募集资金利息收入 9.86 万元。

注 2：经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审批通过，决定将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”募集资金投入金额减少 6,736.97 万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目”。调整后“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”承诺使用募集资金投入金额为 25,242.58 万元，“电子封装陶瓷材料扩产项目”调整后承诺使用募集资金投入金额为 20,407.83 万元。

注 3：电子封装陶瓷材料扩产项目未达预计效益的原因：一是市场竞争日益激烈，产品价格未达预期。近年来，国内氮化铝产业投资规模不断扩大以及需求端对低成本的诉求，产品销售价格与预测价格差异较大。二是大规模扩产后，良品率未达预期。由于首次采用国产连续炉，前期进行设备调试、产品进行验证的周期延长，导致氮化铝产品扩产后良品率未达预期，造成生产成本上升。三是加大产品研发投入。项目执行期间，由于新的技术路径与细分应用场景不断涌现，并展现出潜在的市场空间；为把握发展机遇、构建面向未来的产品组合，降低因产品更新可能带来的长期风险，公司加大了产品研发投入，进而影响了最终收益。

注 4：电子陶瓷材料产业化项目（一期）未达预计效益的原因：一是市场竞争日益激烈，产品销售价格未达预期。近年来，国内氮化铝产业投资

规模不断扩大以及需求端对低成本的诉求，产品销售价格与预测价格差异较大。二是大规模扩产后，良品率未达预期。由于首次采用国产连续炉，前期进行设备调试、产品进行验证的周期延长，导致氮化铝产品扩产后良品率未达预期，造成生产成本上升。三是加大对产品研发投入。由于技术趋势及客户需求快速转变，为把握发展机遇、降低因产品线单一可能带来的长期风险，公司经过审慎评估，决定在确保原定项目顺利推进的同时，新增 250W/m.k 高导热氮化铝和 550MPa 以上高抗弯氮化铝的研发投入。上述研发投入也对实际收益与预期收益之间的差距产生了一定影响。四是氮化硅项目投资进度不及预期。氮化硅项目规划中，其原粉计划从国内采购或者进口，由于国内原粉性能指标未完全成熟，导致项目整体实施有所延后。此情况直接影响了电子陶瓷材料产业化项目（一期）的预期销售收入，从而对收益造成一定影响。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年非公开发行股票												
募集资金到账日期			2022 年 9 月 5 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
电子封装陶瓷材料扩产项目	电子封装陶瓷材料扩产项目	生产建设	宁夏北瓷新材料科技有限公司	宁夏	20,407.83	20,407.83	1,309.23	18,506.02	90.68	2025 年 10 月	-2,296.43	否	否	2024 年 11 月 11 日	
电子陶瓷材料产业化项目(一期)	电子陶瓷材料产业化项目(一期)	生产建设	成都旭瓷新材料有限公司	成都	25,242.58	25,242.58	6,328.82	22,863.02	90.57	2025 年 10 月	-881.19	否	否	2024 年 11 月 11 日	
合计					45,650.41	45,650.41	7,638.05	41,369.04	-	-	-3,177.62	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					1、“电子封装陶瓷材料扩产项目”：随着第三代半导体技术的快速发展，市场对散热效率提升和功耗降低的需求愈加凸显。氮化铝材料因其出色的导热和散热性能，市场应用领域不断扩展，其核心作用愈发显著；与此同时，对氮化铝粉体的性能指标也提出了更高要求。随着公司在氮化铝粉体工艺方面取得的突破，现有生产设备及能源配套不足，需进一步增加资金										

	<p>投入。2、“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”：氮化硅基板涉及的制造工艺复杂，并且生产验证周期较长，因此为保证募集资金使用效益及保护中小投资者权益，为进一步加强募集资金使用的统筹规划，经公司结合实际需要谨慎研究决定，在保持募投项目实施主体、投资总额不变的情况下，将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”中氮化硅生产线计划不再使用募集资金投入，未来拟使用自有资金投入。综上，“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”减少的募集资金投入调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目”。上述事项已经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审批通过。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>详见附表 1 之“未达到计划进度原因”</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>